



端子 and 接头 &gt; PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

端子电镀材料: 无镀层

封装方法: 零散零件

产品端接到: 印刷电路板

## 产品特性

### 产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

### 接触件特性

PCB 端子类型	公端
----------	----

端子电镀材料	无镀层
--------	-----

端子方向	直角
------	----

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

### 机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

### 尺寸

螺钉直径	3.3 mm[.13 in]
------	----------------

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围

90 °C[194 °F]

### 包装特性

封装数量

150

封装方法

零散零件

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

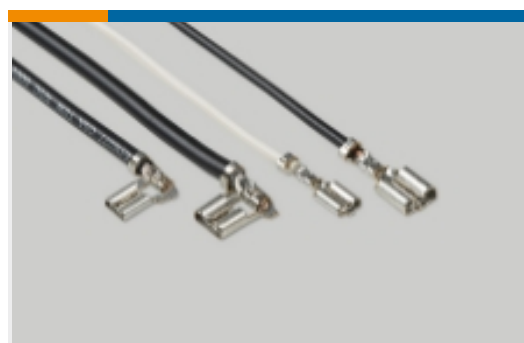
#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 该系列中的其他产品 | AMP CAP



PCB 端子(2)



快速断开(1)



矩形电源连接器(9)

## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1659217-0\\_O\\_c-1-1659217-0-o.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1659217-0\\_O\\_c-1-1659217-0-o.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1659217-0\\_O\\_c-1-1659217-0-o.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Utilux Catalogue Section](#)

英文版本